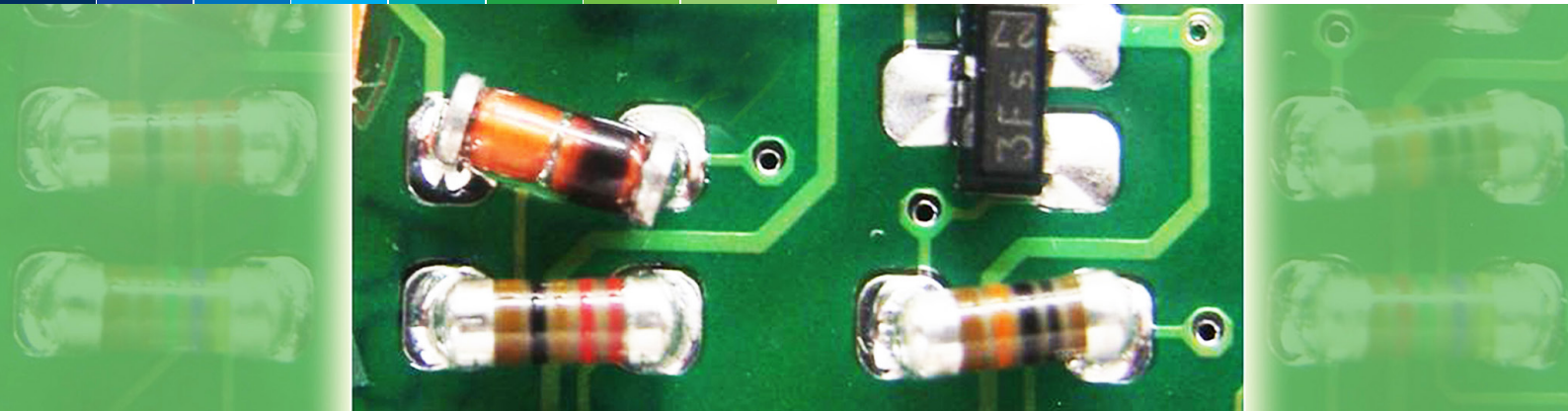


Fehlermanagement in der Elektronikfertigung



09. Dezember 2026 in Blaubeuren

Seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts streben die Elektronikfertiger weltweit eine Null-Fehler-Qualität an. Dennoch scheint das Ziel absolut nicht erreichbar. Neue Aufbau- und Verbindungstechnologien sowie stetig wachsende Bestückdichten und eine größere Bauelementevielfalt generieren mehr und oft auch neue Fehlerarten. Das Seminar diskutiert viele Ursachen der Entstehung von Lötfehlern und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung.

Teilnehmerzahl: max. 30 Personen

Vorbehaltlich inhaltlicher Anpassungen

Schulungsdauer: 1 Tag

Teilnahmegebühr: 349 p.P. € inkl. Tagungsgetränken, Mittagessen, Schulungsunterlagen

09. Dezember 2026

09:00 Uhr	Begrüßung	13:00 Uhr	Mittagspause
09:15 Uhr	Erhöhte Qualität und Zuverlässigkeit elektronischer Baugruppen durch fertigungsgerechtes Leiterplattendesign <i>Helge Schimanski, Fraunhofer ISIT</i>	13:45 Uhr	Workshop 1 Vermeidung von Defekten im Druckprozess <i>Torsten Vegelahn, ASYS Group</i> <i>Frank Beer, Christian Koenen</i>
10:00 Uhr	Fehlermanagement im Schablonendruck Auswirkung von Prozessparametern und Schablonendesign <i>Torsten Vegelahn, ASYS Group</i> <i>Frank Beer, Christian Koenen</i>		Workshop2 Benetzungsergebnisse und weitere Fehlerarten aus der Praxis <i>Dr. Paul Wild / Nico Fahrner, Rehm Thermal Systems</i>
10:45 Uhr	Kaffeepause	15:00 Uhr	Kaffeepause
11:00 Uhr	Lotperlen und Flußmittelspritzer Einfluss der Lotpaste, Leiterplatte und des Lötptofil <i>Dr. Paul Wild, Rehm Thermal Systems</i>	15:15 Uhr	XY-Versatz, Selfalignment, Nichtlötungen und Brücken Ursachen und Vermeidung <i>Dr. Paul Wild, Rehm Thermal Systems</i>
11:40 Uhr	Voids Material-, design- und prozessspezifische Faktoren <i>Dr. Paul Wild, Rehm Thermal Systems</i>	15:45 Uhr	Whiskers, Black-Pad, Wicking und Graping Entstehungsmechanismen und Abhilfemaßnahmen <i>Dr. Paul Wild, Rehm Thermal Systems</i>
12:20 Uhr	Tombstones Auswirkung von Lötparameter und Design <i>Dr. Paul Wild, Rehm Thermal Systems</i>	16:30 Uhr	Ende des Seminars Zeit für Diskussion und Gewinnspiel



TECHNOLOGY ACADEMY

Hier geht es direkt zur Anmeldung:

